



# 臺科大 半導體產業 高階碩士在職學程 SEMI-EMRD

鄭正元

台科大機械系特聘教授

環球晶圓、朋程科技、艾恩特實業公司獨立董事

Email: [jeng@mail.ntust.edu.tw](mailto:jeng@mail.ntust.edu.tw)

Mobile: 0970030600

Line: [jyjeng](#)

2021年7月



EMRD ? ? ?

# 科技產業專屬 的EMBA



# 半導體產業鏈內專業再精進

## 120位

台積電與環球晶及盟立等產官學研各領域企業主管與專家灌頂，集

# 技術脈、人脈與產業脈



# 學程課程與特色

- IC設計、製造、封測與相關應用產業，並包含供應鏈的設備與材料及檢驗等

- 最具特色的是

半導體講座

半導體專利

營業秘密案例、積體電路佈局法、競爭法案例

與企業併購法等科技法規

- 盧明光董事長協助設計與推薦師資的

半導體營業模式與募資及併購

- 大陸半導體產業與技術發展



# 半導體產業 總經理、董事長等高階主管 也需要的進修

## 半導體講座

營業秘密案例、積體電路佈局法、競爭法案例  
與企業併購法及反托拉斯法等科技法規

- 盧明光董事長協助設計與推薦師資的  
半導體營業模式與募資及併購



半導體產業鏈外人才轉業或進修

如果你不在半導體產業，  
你要進入全台灣平均薪資最高  
的半導體產業嗎？



環球晶董事長  
徐秀蘭  
極力推薦  
並將派公司同仁  
進修相關課程

朋程、大同董事長  
盧明光  
協助設計安排  
併購與私募課程



環球晶圓股份有限公司

新竹科學工業園區工業東二路 8 號

TEL: 03-5772255

FAX: 03-5781706 / 03-5790405

www.sas-globalwafers.com

極力推薦

台科大半導體高階產業碩士在職學程 SEMI-EMRD

鄭正元教授為本公司獨立董事，六年前創辦高階科技研發碩士在職學程 EMRD，本公司曾推薦一位資深經理到台北就讀，兩年前該員已升職為處長，顯見 EMRD 學程的確對人才培育具有極佳成效。

鄭教授進一步針對半導體產業高階經營與研發人才設計一序列課程之 SEMI-EMRD 並將於竹北開課，除 IC 設計、製造、封測、材料與設備及各式應用，更含括半導體專利與智財鑑價、營業秘密、競爭法與企業併購法等科技法規。除此之外，也包含半導體產業營運模式與併購等內容，並將由中美矽晶盧明光榮譽董事長協助設計與安排私募與併購相關課程與師資。

如上述之內容，SEMI-EMRD 課程與師資精彩可期，必能協助台灣系統化培訓半導體高階經營與研發中堅幹部，中美矽晶集團公司亦將鼓勵優秀員工進修相關課程，以培養公司專業人才，增進公司競爭力。

中美矽晶/環球晶圓/台特化董事長 徐秀蘭

徐秀蘭



# 半導體科技總論

掌握最新半導體專業與產業科技領域發展趨勢





# 課程地圖(暫訂)

111學年度起適用

## 專業 核心

半導體科技總論(一) (3)  
半導體科技總論(二) (3)  
半導體產業營運模式暨併購(3)  
IC設計(3)  
IC製造(3)  
半導體封測與PCB(3)  
光電暨顯示  
半導體設計與製造暨應用(3)  
POWER IC設計與製造暨應用(3)  
半導體設備與材料(3)  
管理(一) (3)  
管理(二) (3)  
(33學分)

## 智財 核心

科技法規總論 (3)  
半導體專利 (3)  
智財鑑價暨侵權訴訟(3)  
(9學分)

## 專業 必修

半導體產業講座(一) (2)  
半導體產業講座(二) (2)  
專題研究(一) (1)  
專題研究(二) (1)  
學術論文與寫作(一)(1)  
學術論文與寫作(二)(1)

論文—公司的3-5年技術或產品藍圖  
董事長或總經理共同指導教授

**SEMI-EMRD課程畢業學分共 45學分**

## 跨領域 選修

工程產業技術 (3)  
電子產業技術 (3)  
研發管理實務 (3)  
**科技產業趨勢與策略分析 (3)**  
財務分析與應用 (3)  
**創新創業實務 (3)**  
產品創意設計 (3)  
**企業參訪(1)**  
**海外企業參訪 (2)**  
**藝術鑑賞 (2)**

(本校選修課程15學分)





# 進修充電最佳選擇

臺科大  
半導體產業  
高階碩士在職專班  
SEMI-EMRD

半導體產業學分班(先修)

# 先修學分班

- 週六上課 9-12:00、13-14:30、15:-18:00
- 2021年9月18日-1月22日
  - 半導體科技總論(一)—3學分
  - 半導體產業講座(一)—1學分
  - 科技法律—3學分
- 2022年2月-6月
  - 半導體科技總論(二)—3學分
  - 半導體產業講座(二)—1學分
  - 半導體產業營運模式暨併購—3學分

- 每學分11,000元
- 報名至少4學分4萬4000元
- 可選讀部分課程，每課程4000元，每科目至少5課程，講座課程不開放
- 上課地點:台科大竹北校區或遠距教學
- 若獲得入學，則學分可以抵免畢業學分
- 2021年9月開始學分班
- 2022年9月入學EMRD學程半導體組(需依照招生入學考試)
- 2023年入學或原EMRD轉換SEMI-EMRD獨立學程





# 聯絡資訊—**半導體產業學分班**SEMI-EMRD

鄭正元

台科大機械系教授

Email: jeng@mail.ntust.edu.tw

Tel: 02-27376714

Mobile: 0970030600

Email: [jeng@mail.ntust.edu.tw](mailto:jeng@mail.ntust.edu.tw)

Line: jyjeng

<https://emrd.ntust.edu.tw/p/412-1039-10033.php?Lang=zh-tw>

Google 搜尋—[半導體產業學分班](#)



# 半導體產業高階碩士在職專班設立目標

為培育台灣半導體產業工程技術人才，教育部已推動「國際半導體產業學院」之成立。本學程主要著重於具全球移動力及跨領域高階人才培育，將邀請約100多位具產官學研經驗豐富擔任講師，搭建全方位半導體暨供應鍊產業高階經營暨研發人才培育。

本校除了有EMBA、EMRD培訓專業的技術管理人才外，為因應半導體產業高階人才需求，擬成立半導體產業高階碩士在職專班，以培訓半導體產業含其供應鏈之高階經營及研發人才，打造具創新、前瞻性之世界級半導體研發重鎮與培育跨世紀半導體暨供應鍊產業高階經營暨研發人才。

**NOTE：職能定義:CTO(EMRD)—瞭解半導體既最新科技產業趨勢、掌握全球研發動脈+投入企業研發資源→轉換成公司可銷售之產品或無形智財的競爭力+在科技法律許可下**

# 課程地圖

111學年度起適用

## 專業 核心

半導體科技總論(一) (3)  
半導體科技總論(二) (3)  
半導體產業營運模式暨併購(3)  
IC設計(3)  
IC製造(3)  
半導體封測與PCB(3)  
光電暨顯示  
半導體設計與製造暨應用(3)  
POWER IC設計與製造暨應用(3)  
半導體設備與材料(3)  
管理(一) (3)  
管理(二) (3)  
(33學分)

## 智財 核心

科技法規總論 (3)  
半導體專利 (3)  
智財鑑價暨侵權訴訟(3)  
(9學分)

## 專業 必修

半導體產業講座(一) (2)  
半導體產業講座(二) (2)  
專題研究(一) (1)  
專題研究(二) (1)  
學術論文與寫作(一)(1)  
學術論文與寫作(二)(1)

論文—公司的3-5年技術或產品藍圖  
董事長或總經理共同指導教授

SEMI-EMRD課程畢業學分共 45學分

## 跨領域 選修

工程產業技術 (3)  
電子產業技術 (3)  
研發管理實務 (3)  
科技產業趨勢與策略分析 (3)  
財務分析與應用 (3)  
創新創業實務 (3)  
產品創意設計 (3)  
企業參訪(1)  
海外企業參訪 (2)  
藝術鑑賞 (2)

(本校選修課程15學分)





# 課程規劃

## 一上

半導體科技總論(一) <3>  
半導體產業講座(一) <1>  
管理(一) <3>  
半導體專利(一) <3>  
半導體科技與法律 <3>

## 一下

半導體科技總論(二) <3>  
半導體產業講座(二) <1>  
管理(二) <3>  
IC設計 <3>  
半導體營運模式暨併購 <3>  
學術論文與寫作 <1>

## 一暑

專題研究(一) <1>  
IC製造 <3>  
半導體設備與材料 <3>  
科技與產業地圖分析 <3>

## 二上

專題研究(二) <1>  
半導體封測與PCB <3>  
光電暨顯示半導體設計與製造暨應用 <3>  
功率半導體設計與製造暨應用 <3>

## 二下

- ✓ 無必修課
- ✓ 依興趣彈性開授選修
- ✓ 開放校友免費修課

**二下前**修畢45學分

畢業

## 《專業選修》

工程產業技術  
創新創業實務  
電子電機技術  
產品創意設計  
智財營運管理

材料產業

藝術鑑賞

人文美學

新興科技

產業分析

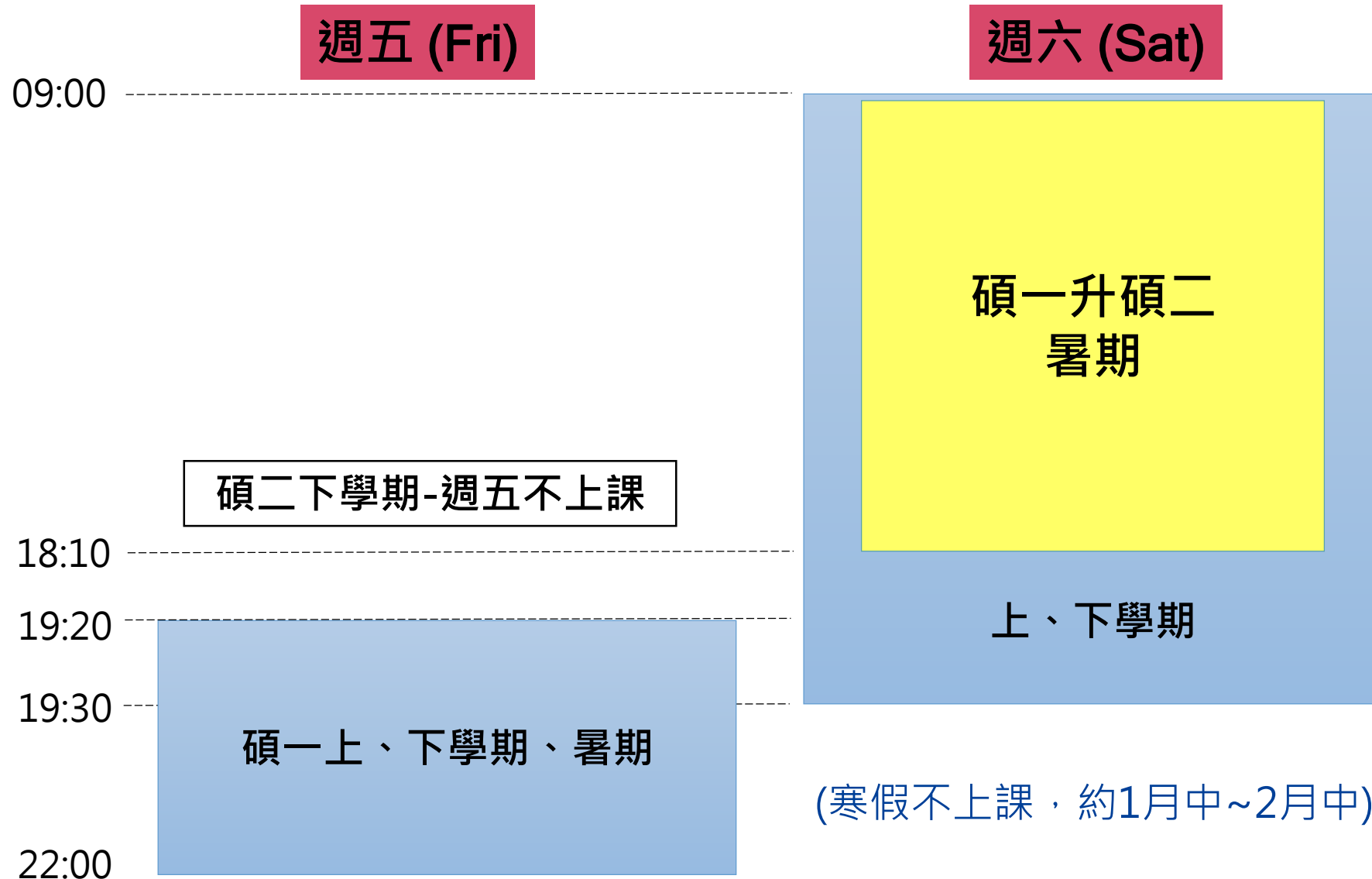
科技法規

國內外企業參訪





# 上課時間表



# 修業規定

- 年限：1~4年。
- 畢業條件：**45**學分 + 學位論文(與口試)。
- 口試條件：修畢45學分後，可申請口試。

## 學雜費 (109學年度標準)

- 每學期學雜費 **15,380** 元 + 學分費 **147,600** 元。  
(與保險費、網路通訊費約700元，總額約163,680元/學期)
- 共收**5**學期 (3+2)合計約818,400元+班費(學程活動費) 總計約90萬。

\*110學年度在職專班之學雜費及學分費收費標準以本校行政會議決議後之正式公告為準。



# 半導體科技總論

掌握最新半導體專業與產業科技領域發展趨勢



# 必修課講師群(暫訂)

## 半導體科技總論



- 陽明交通大學副校長 李鎮宜特聘教授
- 中芯半導體獨立董事、前台積電研發處處長 楊光磊博士
- 臺科大電子系 李三良講座教授
- 臺科大機械系、環球晶、朋程獨立董事 鄭正元特聘教授
- 台科大 洪儒生、劉國讚、陳曉慧

## 半導體專利



- 經濟部智慧財產局 廖承威 副局長
- 智慧財產局專利一組 林希彥組長
- 智慧財產局專利一組 張睿哲副組長
- 德恒律師事務所 袁建中高級顧問

## 半導體產業營運模式暨併購

- 今周刊顧問 林宏文
- 朋程科技公司 盧明光董事長

## 科技與產業地圖分析



- DIGITIMES 黃欽勇社長 & 產業分析師
- 國際半導體產業協會

## 半導體科技與法律



- 資策會科法所王偉霖所長
- 國立台北科技大學智慧財產研究所所長 郭宏杉教授
- 淡江大學莫內講座教授陳麗娟教授
- 資策會科法所鄒宗萱副主任
- 台科大科管所 陳曉慧教授

## 半導體講座(一)(二)



- 清大科管學院 史欽太院長
- 工研院董事長 李世光董事長
- 聯發科、環球晶、盟立、穩懋、聯電、家登、帆宣等高階主管

## 管理(一)(二)



- 台科大財金所 陳俊男所長
- 台科大工管系 王孔政教授
- 台科大資管系 李國光教授
- 台科大企管系 林孟彥教授
- 台科大企業管理系 曾盛恕主任
- 經緯智庫股份有限公司 許書揚總經理



# EM-SEMI 兩年課程表(暫訂)

序號	學期	課程	必修/選修	學分數	上課 (F/S)	教師
1	110-01	半導體科技總論(一)	必	3	S	鄭正元
2	110-01	半導體產業講座(一)	必	1	S	鄭正元
3	110-01	半導體專利	必	3	S	劉國讚
4	110-01	管理(一)	必	3	S	陳俊男、王孔政、李國光
5	110-01	科技產業趨勢與策略分析	必	3	F	資策會MIC-詹文男(兼)、林柏齊(兼)
6	110-02	半導體科技總論(二)	必	3	S	鄭正元
7	110-02	半導體產業講座(二)	必	3	S	鄭正元
8	110-02	管理(二)	必	3	S	曾盛恕、陳傳非(兼)、許書揚(兼)、林孟彥
9	110-02	IC 設計	必	3	S	李鎮宜
10	110-02	半導體科技與法律	必	3	F	陳曉慧、陳麗娟(兼)、鄒宗萱(兼)、楊采文(兼)
11	110-暑	IC 製造	必	3	F	楊光磊
12	110-暑	專題研究(一)	必	1	S	鄭正元
13	110-暑	半導體設備與材料	必	3	S	鄭正元
14	110-暑	學術論文寫作	選	1	S	林隆儀(兼)
	111-暑	智財鑑價暨侵權訴訟		3		
15	110-暑	海外企業參訪	選	2	X	
16	111-01	專題研究(二)	必	1	S	
17	111-01	半導體封測與PCB	必	3	S	李鎮宜
18	111-01	光電半導體設計與製造暨應用	必	3		李三良
19	111-01	功率半導體設計與製造暨應用	必	3		邱煌仁
20	111-01	半導體產業營運模式暨併購	必	3	S	盧明光
21	111-01	創新創業實務	選	3	F	張紹堯(兼)
22	111-02	企業參訪	選	1	F	鄭正元
23	111-02	藝術鑑賞	選	2	S	陳彥廷、林品青(兼)
24	111-02	半導體設計與實作	選	3	S	實習費另收
		畢業學分--45		63		



# 半導體科技總論(一)(二)

週次	課程主題	授課教師	課程內容簡介
1	學程暨半導體產業總論	鄭正元、黃逸平-DIGITIMES副總	本學程旨在整合產官學研專家學者，全面跨域培養培育高階半導體產業人才
2	積體電路設計技術與產業	李鎮宜	
3	半導體製造	楊光磊	
4	國慶日	停課	
5	光電半導體設計製造與應用及產業	李三良	
6	功率半導體設計製造與應用及產業	張翼	
7	SOC IC設計與應用及產業	聯發科	
8	高速IC設計與產業	祥碩-邀請中	
9	大陸半導體技術與產業	羅仕洲	
10	期中考	鄭正元	
11	光罩暨光學微影技術與產業	ASML	
12	半導體晶圓材料	合晶	
13	半導體化學品材料	洪儒生	
14	半導體製造設備與產業	盟立自動化	
15	半導體營業模式與併購	林宏文	
16	半導體產業專利總論	劉國讚	
17	半導體產業科技法規	陳曉慧	智財管理、積體電路電路佈局保護法、營業秘密、競爭法、企業併購相關法規
18	期末考	鄭正元	

週次	課程主題	課程內容簡介	授課教師
1	晶片通路		大聯大或文燁
2	電動車技術與產業MIH		
3	電動車動力系統技術與產業		
4	人工智慧AI		
5	5G+WiFi6手機技術與產業		
6	機器人技術與產業		
7	語音辨識技術與產業		
8	圖形辨識技術與產業		
9	工業電腦技術與產業		
10	期中考		
11	AIoT技術與產業		
12	無人車技術與產業		
13	無人機技術與產業		
14	量子計算與雲端計算		張慶瑞
15	資安技術與產業		吳宗成
16	低軌道衛星技術與產業		太空中心
17	太陽能科技與產業		藍崇文
18	期末考		



# 半導體產業講座(一)(二) (暫訂)

週次	課程主題	授課教師	課程內容簡介
1	台灣半導體科技與產業發展歷程	史欽泰教授	
2	工研院半導體技術與服務	吳志毅所長	
3	聯發科	高階主管	
4	國慶日	停課	
5	記憶體公司	高階主管邀請確認中	
6	聯詠	高階主管	
7	朋程	高階主管	
8	穩懋	高階主管	
9	精材	高階主管	
10	鴻海	高階主管	
11	環球晶	高階主管	
12	學員推薦	待邀請	
13	帆宣	高階主管	
14	聯電	高階主管	
15	學員推薦	待邀請	
16	家登	高階主管	
17	學員推薦	待邀請	
18	期末考	鄭正元	

週次	課程主題	授課教師	課程內容簡介
1	聯電		
2	力積電		
3	群連		
4	閎康		
5	原相		
6	宏捷科		
7	強茂		
8	文曄		
9	嘉聯益		
10	期中考	鄭正元	
11	南亞		
12	鈐象		
13	大立光		
14	中強光電		
15	友達		
16	瑞儀		
17	國巨		
18	期末考	鄭正元	



# IC設計-李鎮宜(暫訂)

週次	課程主題	授課教師	課程內容簡介
1	半導體製程的演進與產業板塊移動	李鎮宜	
2	半導體晶片產業生態系		
3	半導體晶片設計流程		
4	晶片設計電腦輔助設計軟體		
5	晶片設計基本模組		
6	記憶體晶片 (Memory Chip)		
7	通用型中央處理器(CPU)		
8	特殊用途積體電路晶片 (ASIC)		
9	晶片系統(System-on-Chip)		
10	期中考	鄭正元	
11	感測晶片		
12	A I 晶片		
13	網通晶片		
14	車用晶片		
15	綠能晶片		
16	醫用晶片		
17	邁向晶片大未來		本課程主要介紹半導體晶片設計的演進，以及所衍生的晶片對於系統應用與創新服務所造成的產業板塊移動與變革。
18	期末考	鄭正元	



# 半導體製程-楊光磊

.週次	課程主題	授課教師	課程內容簡介
1	半導體製程概論	楊光磊	
2	半導體製程模組一 光罩	TBD	
3	半導體製程模組二 光刻	TBD	
4	半導體製程模組三 蝕刻	TBD	
5	半導體製程模組四 擴散/清洗	TBD	
6	半導體製程模組五 薄膜	TBD	
7	半導體製程模組六 CMP	TBD	
8	半導體製程模組七 ECP	TBD	
9	半導體製程整合	楊光磊	
10	期中考	鄭正元	
11	半導體元件一	陳一浸	
12	半導體元件二	陳一浸	
13	半導體記憶體製程一	白培霖	
14	半導體記憶體製程二	白培霖	
15	半導體製造系統	廖大穎	
16	期末報告	楊光磊,鄭正元	
17	期末報告	楊光磊,鄭正元	
18	期末考	鄭正元	

# 半導體產業營運模式暨併購-盧明光(暫訂)

	課程主題	授課教師	課程內容簡介
1	全球半導體產業從歐美、日本到韓國、台灣及中國的發展歷程與演變	林宏文	楊應超、陸行之、程正樺、蘇孟宗
2	IDM的沒落，以及晶圓代工產業的崛起及茁壯	李明哲、楊瑞臨	
3	3, 記憶體產業的發展、併購及重整	林育中、楊瑞臨	
4	IC設計的發展及成功要素	程正樺、王興毅	
5	5, 封裝測試、IC通路的發展歷程與競爭要素	李金恭，曾國棟， 蘇孟宗	
6	半導體晶圓、材料、CAD及設備產業的發展	李明哲，宋栢安	
7			
8			
9			
10	期中考	鄭正元	
11	私募與併購		
12	聯發科與IC設計產業併購		
13	環球晶與晶圓產業併購		
14	鴻海與電子產業併購		
15			
16			
17			
18	期末考	鄭正元	

# 光電半導體設計與製造應用-李三良(暫訂)

週次	課程主題	授課教師	課程內容簡介
1	光電半導體元件概論	李三良	介紹光電半導體元件種類與應用
2	光通訊光電半導體元件及製造	索爾思光電/穩懋	介紹光通訊光電半導體元件與製造
3	光通訊光電半導體元件及製造	索爾思光電/穩懋	介紹光通訊光電半導體元件與製造
4	LED原理與應用	郭浩中	介紹LED原理與製造 (含MiniLED)
5	照明用LED原理與製造	晶元光電	介紹照明LED原理與製造
6	MicroLED原理與製造	李允立(銓創)	介紹MicroLED原理與製造,含巨量轉移與修補
7	OLED原理與應用	吳忠熾	介紹OLED原理與在顯示照明的應用
8	顯示產業技術概況	群創/友達	介紹產業技術概況與趨勢
9	DLP projector技術概況	中強	介紹DLP projector技術概況與趨勢
10	期中考	李三良	
11	光感測器概論	TBD	介紹各式光電感測器與轉能器與應用
12	光檢測器的原理與應用	葉秉慧	介紹檢光器原理與製造
13	光感測用VCSEL雷射	光環	介紹VCSEL原理與在Face ID與LIDAR應用
14	光電半導體磊晶技術	聯亞光電	介紹各式光電半導體元件的磊晶技術
15	矽光子積體電路概論與應用	徐世祥	介紹矽光子積體電路原理
16	矽光子積體電路設計與製造	TSRI	介紹矽光子積體電路元件設計與製造
17	光電半導體元件的封裝技術	鴻海/日月光	介紹光電半導體元件的封裝技術
18	期末考	李三良	

# POWER IC設計與製造暨應用-邱煌仁(暫訂)

週次	課程主題	授課教師	課程內容簡介
1-2	功率半導體概論		基本電學：電子 / 電洞 / 電壓 / 電流 / 功率 / 焦耳 / 頻率 / 輸入 / 輸出
			功率半導體元件符號 / 功能 / 特性說明
			被動元件符號 / 功能 / 特性說明
			類比IC 種類 / 功能 / 特性說明
			常見Topology, 如Flyback, Buck, Boost, class AB, class D
			發展歷程 / 未來趨勢
			產品開發 (設計->晶圓製程->封裝與測試)
			功率元件及類比IC供應鏈
			終端客戶應用概述
3-4	功率元件及類比IC 設計		Diodes / BJT / MOSFET / IGBT / TVS
			電源管理IC / 動力控制IC / 驅動IC / 功率放大器
5-6	晶圓製程		功率元件Trench & Planar 製程 / 寬能隙半導體材料 GaN & SiC
			類比IC製程
7-8	封裝與測試		功率元件_標準品 / 微型化 / 功率型 / 模組型
			類比IC_標準品 / 微型化 / 功率型 / 複合型
9-10	終端客戶應用與商機		功率元件應用及未來趨勢_車用 / 工業 / 電腦運算 / 網路通訊 / 消費性電子
			類比IC應用及未來趨勢_車用 / 工業 / 電腦運算 / 網路通訊 / 消費性電子
11	期中考		
12	產品開發專案管理		市場訊息收集 / 產品線規劃 / 產能 / 毛利額 / 毛利率 / 案件追蹤 / 達成率分析與檢討
13	IDM大量生產製造		原物料 / 機台 / 產能利用率 / 良率 / 成本分析 / 自動化 / 工廠管理 / 機台折舊率攤提
14	功率元件及類比IC專利佈局		新產品開發與專利佈局 / 迴避競業既有專利
15	功率半導體設計可靠度風險分析實務	伍錦輝	設計壽命曲線/量測/技術及運用方法/零件材料用選用/耐熱耐寒環境與失效
16-17	企業成功典範及未來展望		邀請上市櫃公司總經理/副總經理演講
18	期末考		

# 半導體設備與材料-鄭正元(暫訂)

週次	課程主題	授課教師	課程內容簡介
1	供應鏈總論	鄭正元	
2	矽晶圓材料與製造		
3	化合物半導體晶圓材料與製造	環球晶	
4	微影技術設備	ASML	
5	CMP技術設備	美國應材	
6	成膜設備	東京威力科創	
7	蝕刻與沉積設備製造	科林研發	
8	光阻劑與化學品材料與製造		
9	靶材材料與製造	光洋科	
10	期中考	鄭正元	
11	半導體制造相關的制程控管、良率管理服務	科磊	
12	E-BEAM與AOI技術與設備	ASML	
13	半導體廠建置	漢唐	
14	光罩設計與製造	台灣光罩	
15	光罩盒設計與製造	家登精密	
16	晶片封裝設備與材料		
17	自動化	盟立	
18	期末考	鄭正元	

# 半導體封測與PCB-李鎮宜(暫訂)

週次	課程主題	授課教師	課程內容簡介
1	晶片封裝技術的過去、現在、與未來	李鎮宜	
2	二維電路設計與封裝方案		
3	封裝堆疊(Package on Package or PoP)		
4	先進封裝CoWoS介紹 (Chip on Wafer on Substrate)		
5	先進封裝InFo介紹 (Ingrated Fan-Out)		
6	矽穿孔(Through Silicon Via or TSV) 與同質堆疊		
7	三維積體電路與系統封裝		
8	晶圓層級封裝		
9	Chiplet ( 小晶片 或晶粒 )		
10	期中考	鄭正元	
11	CP & FT TEST	美達	
12	載版	欣興	
13	PCB曝光機		
14	SMT系統		
15	PCB 材料		
16	PCB 鑽孔		
17	天線設計與製造	連展	
18	期末考	鄭正元	

# 半導體專利(暫訂)

週次	課程主題	授課教師	課程內容簡介
1	專利法導論(與審查相關部分)		
2	產業利用性及新穎性基準暨案例研析		
3	新穎性與重複授權、創造性判斷實務		
4	大陸專利撰寫品質要求實務		
5	大陸專利整體架構介紹		
6	大陸專利保護技術態樣與各國之異同		
7	進步性基準暨案例研析		
8	舉發基準暨案例研析		
9	研發計畫之專利策略與布局		
10	期中考	鄭正元	
11	發明提案之專利檢索策略		
12	商情蒐集之專利監控策略		
13	專利地圖之繪製與運用		
14	專利行政救濟案例研析		
15	專利侵害判斷		
16	專利民事訴訟案例研析		
17	期末報告		
18	期末考	鄭正元	

週次	課程主題	授課教師	課程內容簡介
1	營業秘密	資策會科法所王偉霖所長	
2	營業秘密	資策會科法所王偉霖所長	
3	營業秘密	資策會科法所王偉霖所長	
4	國慶日	停課	
5	智慧財產權1	國立台北科技大學智慧財產研究所所長郭宏杉教授	
6	智慧財產權2	國立台北科技大學智慧財產研究所所長郭宏杉教授	
7	智慧財產權3	國立台北科技大學智慧財產研究所所長郭宏杉教授	
8	智慧財產權管理1	資策會科法所鄒宗萱副主任	
9	智慧財產權管理2	資策會科法所鄒宗萱副主任	
10	資安與隱私1	創拓國際法律事務所資深顧問楊采文律師	
11	資安與隱私2	創拓國際法律事務所資深顧問楊采文律師	
12	資安與隱私3	創拓國際法律事務所資深顧問楊采文律師	
13	供應鏈法1：全球化趨勢	歐盟莫內講座教授陳麗娟博士	
14	供應鏈法2：中國崛起之影響	歐盟莫內講座教授陳麗娟博士	
15	供應鏈法3：進入歐洲單一市場	歐盟莫內講座教授陳麗娟博士	
16	供應鏈法4：印太策略下之亞洲企業	歐盟莫內講座教授陳麗娟博士	
17	供應鏈法5：綠色供應之因應	歐盟莫內講座教授陳麗娟博士	
18	期末考	陳曉慧	台灣科技大學科技管理研究所副教授。專長智慧財產權。





# 管理(一)(二)暫訂

週次	課程主題	授課教師
1	策略知識管理(一)	資管系李國光教授
2	策略知識管理(二)	資管系李國光教授
3	策略知識管理(三)	資管系李國光教授
4	策略知識管理(四)	資管系李國光教授
5	策略知識管理(五)	資管系李國光教授
6	財務管理導論	財金所 陳俊男教授
7	財務報表編製與分析	財金所 陳俊男教授
8	投資策略與資本預算	財金所 陳俊男教授
9	融資策略、資本結構和槓桿	財金所 陳俊男教授
10	期中考	鄭正元
11	股利策略與股票購回	財金所 陳俊男教授
12	生產管理-產品設計	工管系 王孔政教授
13	生產管理-工作系統設計、製程設計	工管系 王孔政教授
14	生產管理-品質設計	工管系 王孔政教授
15	生產管理-精實系統設計	工管系 王孔政教授
16	生產管理-智慧製造	工管系 王孔政教授
17		
18	期末考	鄭正元

週次	課程主題	授課教師
1	研發管理	楊光磊
2	研發管理	楊光磊
3	策略管理與研究方法	曾盛恕教授
4	策略管理與研究方法	曾盛恕教授
5	行銷管理	林孟彥教授
6	行銷管理	林孟彥教授
7	行銷管理	林孟彥教授
8	行銷管理	林孟彥教授
9	行銷管理	林孟彥教授
10	期中考	鄭正元
11	行銷管理	林孟彥教授
12	人事管理	石虔宇顧問
13	人事管理	石虔宇顧問
14	人事管理	石虔宇顧問
15	人事管理	石虔宇顧問
16	人事管理	石虔宇顧問
17	人事管理	許書揚總經理
18	期末考	鄭正元

# 111學年度報考資訊

(2022年9月入學)

- 招生名額：10名(乙組SEMI-EMRD、甲組36名-入學後可轉組)
- 報名方式：網路報名
- 報名時間：2021年11月底或12月初
- 報名簡章：台科大教務處網頁入學資訊
- 考試科目：書審 ( 50% ) 口試 ( 50% )



# 111學年度報考資訊

(2022年9月入學)

- 報考資格：(考生須符合下列A或B條件之一)

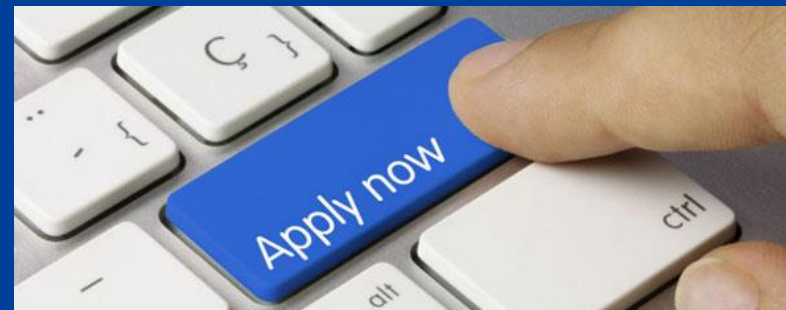
**條件A**：具有學士學位(或同等學力)資格後，再取得至少6年以上工作年資者，服役年資不列計。

**條件B**：符合「專業卓越成就表現同等學力」認定，並具備工作經驗者。

在專業領域具卓越成就表現且具有下列事蹟一至多項者：

- (A)曾獲頒大學相關榮譽學位者
- (B)上市、上櫃公司負責人
- (C)資本額一億以上公司負責人
- (D)曾獲個人專業領域之相關國內外重要競賽獎項者
- (E)其他對國家、社會、人類福祉有具體卓越貢獻者

經本校招生委員會碩博士班招生會議審議通過後，得准其以同等學力報考。



# 先修學分班

- 週六上課 9-12:00、13-14:30、15-18:00
- 2021年9月-1月
  - 半導體科技總論(一)—3學分
  - 半導體產業講座(一)—1學分
  - 半導體科技與法律—3學分
- 2022年2月-6月
  - 半導體科技總論(二)—3學分
  - 半導體產業講座(二)—1學分
  - 半導體產業營運模式暨併購—3學分

- 每學分11,000元
- 報名至少4學分約4萬4000元
- 上課地點:台科大新竹分部
- 若獲得入學，則學分可以抵免畢業學分
- 2021年9月開始學分班
- 2022年9月入學EMRD學程
- 2023年入學或原EMRD轉換SEMI-EMBA&RD學程

